

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-10

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（<u>策略会</u>） </p>
<p>活动参与人员（排名不分先后）</p>	<p>兴证全球基金、景顺长城基金、万家基金、山西证券、太平养老保险、朱雀基金、南方基金、泓德基金、上海国际信托、兴银理财、中银国际证券、中信建投证券、海富通基金、上海运舟私募基金、诺德基金、华泰保兴基金、南京证券、富安达基金、华泰证券、浦银安盛基金、中海基金、泉果基金、上海磐厚投资、交银保险资产、银河基金、财通基金、长信基金、上海大朴资产、博道基金、嘉实基金、永赢基金、金恩投资、长江养老、于翼资产、中航基金、南京证券自营、方正资管、天弘基金、紫薇私募、兴业基金、中银资管、华泰保兴、望正资产、华宝基金、国联安基金、马歇尔韦世、华能贵诚信托、玖鹏资产、磐厚动量、宝盈基金、上海汇博投资、羿鹏基金、紫金矿业投资、大家资管、上海瑞氮资管、浦银安盛、非马投资、淡水泉投资、相聚资本、摩根华鑫、上银基金、大朴投资、富国基金、华泰柏瑞、国华兴益资管、中信证券资管、东海自营、华源证券、申万菱信、友邦保险、兴全基金、上海德邻众福投资、鹏嘉资产、众安保险资管、德邦证券自营、华夏基金、盘京投资、中欧基金</p>
<p>上市公司接待人员</p>	<p>战略发展部总监、证券事务代表：谢丹</p>
<p>时间</p>	<p>2026年5月12日-13日</p>
<p>地点</p>	<p>华源策略会、兴业策略会、浙商策略会、机构投资者所在地</p>
<p>形式</p>	<p>实地调研</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 交流主要内容： Q1、请介绍公司2026年一季度经营业绩情况。 2026年一季度，公司实现营业收入65.96亿元，同比增长37.90%，归母净利润实现8.50亿元，同比增长73.01%，扣非归母净利润累计实现8.49亿元，同比增长75.04%。 </p>

上述变动主要得益于 AI 算力升级及存储市场需求增长，公司产品结构优化，400G 以上高速交换机、光模块占比同比提升，数据中心收入同比增长，产能利用率提升，叠加广州工厂爬坡顺利，推动营收和利润双增。

Q2、请介绍 2026 年一季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。

公司在 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2026 年一季度，PCB 通信、数据中心占 PCB 收入占比环比增加；受消费周期影响，汽车电子收入占比有所下降，其余占比维持稳定。

Q3、请介绍 2026 年一季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的封装基板技术能力。2026 年一季度，公司封装基板业务需求较去年第四季度有所增长，其中处理器芯片类封装基板收入增加、占比有所提升，存储类封装基板收入持续增长。

Q4、请介绍公司近期产能利用率情况。

近期公司综合产能利用率处于高位，其中公司 PCB 业务受益于 AI 算力基础设施硬件相关产品需求的增长，工厂产能利用率维持高位；封装基板业务因存储类、处理器芯片类基板需求拉动，工厂产能利用率延续 2025 年四季度以来的较高水平。

Q5、请介绍公司南通四期及泰国项目爬坡进展。

泰国工厂与南通四期项目于 2025 年下半年顺利连线投产，目前产能正稳步爬坡。因为该项目仍处于爬坡早期阶段，在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高，会对公司利润产生一定影响。公司将持续加强内部能力建设，提前做好潜在难点识别，加快重点客户项目引入进程，尽可能缩短爬坡周期，为业务的进一步拓展提供支持。

	<p>Q6、请介绍公司广州封装基板项目爬坡进展。</p> <p>2025 年以来，公司广州封装基板项目产品线能力持续提升，其中 BT 类封装基板产能爬坡稳步推进，FC-BGA 类封装基板已实现 22 层及以下产品量产，24 层及以上产品技术研发及打样工作按期推进。</p> <p>Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。</p> <p>公司主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2026 年继续受到大宗商品价格变化的影响，覆铜板、铜箔、金盐等关键原材料价格同步上行，对公司盈利水平构成一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>Q8、请介绍公司 2026 年资本开支的方向。</p> <p>2026 年公司资本开支主要聚焦 PCB 与封装基板业务，重点投向无锡高速高密、高多层电子电路产品项目、广州封装基板工厂建设，以及南通四期、泰国工厂项目后续款项支付；同时适时开展技术改造，打开瓶颈、释放产能。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>